

※募集は終了しました。

東京工業大学・東京医科歯科大学マッチングファンド 募集要項

1. 概要：

東京工業大学と東京医科歯科大学（以下東工大、医科歯科大）の統合を視野に、両大学のボトムアップ型共同研究を推進することを目的とし、異分野を横断した研究課題に対して研究費の支援を行う。

2. 対象となる研究：

両大学の研究者が持つ研究アイデア・スキル・知見を組み合わせる異分野融合研究のうち、将来の発展が期待できる優れた着想を持ち、テーマが具体的に決まっている研究。

3. 申請資格：

医学、歯学、理学、工学、情報科学、人文学、社会科学等のうち2分野以上を含む融合研究を計画する者。

- 研究代表者は、東工大に雇用されている教授、准教授、講師、助教、特任教員(※)、研究員(※)とする。

※については以下の点に注意：

- 自身の雇用期間が支援期間中に終了しないこと。
- 本支援に応募し採択された場合、本研究に従事することが可能であること。
- 自身の雇用経費が外部資金等である場合は、雇用されている事業の研究代表者に本支援を受けて研究を進めることが、当該事業に支障がないことを確認した上で応募すること（特に雇用経費の減額等）。

- 東工大、医科歯科大のどちらか一方より「研究代表者」が、他方より「共同研究代表者」が立ち構成された研究チームが申請母体であり、「研究代表者」が所属大学に申請する。
- 研究代表者は、事前に共同研究代表者に同意を得てから申請する。

4. 研究期間

- 支援開始日から2024年7月31日まで。
※支援開始予定時期：2023年12月（ただし、審査の状況によっては変更になる場合もある）

5. 支援申請額：「研究代表者」「共同研究代表者」にそれぞれの所属大学より50万円支援。

6. 採択予定件数：最大6件

7. 経費の執行について

- 学内の経費執行ルールに基づき、研究期間終了までに執行すること。
- 本支援の経費は研究計画に沿わない執行は認めない。

8. 申請方法：以下により、期限までに申請すること。

提出期限：2023年10月13日（金）正午

提出書類：東京工業大学・東京医科歯科大学マッチングファンド 申請書

申請書のダウンロードはこちら↓（東工大 Box）

<https://tokyotech.app.box.com/file/1298612005583>

申請方法：指定の Box に申請書をアップロードした後，

Slack 専用チャンネル#t2-研産本部-賞支援受付-application-tokyotechgrants

より，ワークフロー「Titech-TMDU Matching Fund」で申請を通知する。

提出先（東工大 Box）：

<https://tokyotech.app.box.com/f/d6cad28b3a35461aa004980025c5e2b1>

9. 選考方法：申請書による以下の観点での書面審査によって決定する。

（1）研究目的の妥当性：目的の明確さ、学術的/実用的重要性

（2）研究計画の妥当性：アプローチの的確さ、計画のち密さ

（3）将来の発展性：学術的/実用的発展性

（4）新規融合研究開拓期待：両大学間のこれまでに無い新たな共同研究を誘発する可能性

10. 報告

研究期間終了後研究成果報告書の提出を求める。また、東工大・医科歯科大学の研究者交流の会などの機会において発表を依頼する場合がある。（詳細は別途採択者へ通知。）

11. その他

- ・ 具体的な審査内容については非公開とし、問い合わせには一切応じないものとする。
- ・ 本ファンドは研究支援を目的としており、共同研究契約の締結は不要とする。
- ・ 本学の研究推進，広報活動および，東工大基金へご寄附いただいた方々への報告等の協力を依頼することがある。
- ・ 過去に以下2つの研究助成に採択された研究課題と同内容のものは対象外とする。

2022年11月公募 本学科学技術創成研究院と東京医科歯科大学の共同研究に対する
異分野融合研究助成

2023年5月公募 東京工業大学・東京医科歯科大学マッチングファンド

- ・ 本支援により得た研究成果を発表する場合は助成を受けた旨を記載するものとする。

Acknowledgment (謝辞) の記載例

【英文】 This work was supported by Tokyo Tech-TMDU Matching Fund.

【和文】 本研究は東京工業大学・東京医科歯科大学マッチングファンド、東工大基金の助成を受けたものです。

※本申請書は審査資料として使用するほか、本学の研究戦略策定のために活用させていただきますので予めご了承ください。

以上

【本件問い合わせ先】

研究推進部研究企画課総務グループ（松本，新戸）

内線：3802, 3805 E-mail: ken.award@jim.titech.ac.jp